

各位

会社名 ヒメジ理化株式会社
(コード番号 322A TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 赤錆 充
問合せ先 取締役 管理本部長 大槻 真
TEL 079-336-3221
URL <https://www.himejirika.co.jp/>

当社連結子会社におけるシンジケートローン契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社横浜石英がシンジケートローン契約の締結及び資金の借入を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 資金借入の理由

福島県白河工場にかかる土地購入代金及び建物の建設にかかる設備投資の支払いを目的としております。尚、トランシェ A 総額 22.89 億円については 2025 年 3 月 31 日に借入を予定しております。

2. 借入について

	(トランシェ A)	(トランシェ B)
(1) 形態	タームローン貸付	実行可能期間付タームローン貸付
(2) 組成金額	22.89 億円	6.61 億円
(3) 契約締結日	2025 年 3 月 26 日	
(4) 期間	実行日：2025 年 3 月 31 日 満期日：2030 年 3 月 29 日	コミット開始日：2025 年 6 月 30 日 コミット満了日：2036 年 1 月 29 日
(5) 金利	変動金利	
(6) アレンジャー	株式会社三菱 UFJ 銀行	
(7) 参加金融機関	株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社山陰合同銀行 株式会社百十四銀行 株式会社広島銀行	
(8) 担保等	担保有 当社は、当該債務について連帯保証を行う	

3. 今後の見通し

当社を取り巻く経営環境につきましては、地政学的リスクもあり不透明な状況にあると認識しております。

一方、半導体業界におきましては、様々なトレンドが噂される中、データセンター等を中心としたメモリー半導体の需要は回復するものと予想されます。足元では半導体市場における在庫調整局面の回復遅れにより、当社の受注環境には停滞感が見られますが、半導体デバイスメーカーでは先端半導体の製造工場の新設や増設といった今後を見据えた積極的な設備投資が相次いで計画・実行されており、半導体市場は引き続き着実な拡大が見込まれていることから、当社は今後の中長期的な受注拡大の見通しを変えておりません。

本件借入による 2025 年 12 月期の業績への影響につきましては、現時点では軽微であると考えておりますが、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以上